

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2025-042

北京君正集成电路股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）根据总体规划，经第六届董事会第二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过，将“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”变更为“3D DRAM 芯片的研发与产业化项目”，并由公司下属全资子公司芯成半导体（上海）有限公司承担。原承担“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”的公司全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）将就“车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目”的剩余募集资金进行减资。

近日，合肥君正完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

名称：合肥君正科技有限公司

统一社会信用代码：91340100092860293D

注册资本：贰亿肆仟柒佰万圆整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张紧

成立日期：2014 年 02 月 14 日

住所：安徽省合肥市高新区大龙山路 1855 号君正科技园 C 座一层 101

经营范围：半导体集成电路芯片的研发、设计、委托加工、销售；计算机软硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备的设计、开发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年八月四日